

股票简称：天津普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2024 年年度报告摘要



二〇二五年四月二十六日



证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-014

天津普林电路股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天津普林	股票代码	002134
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	束海峰	李立财	
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号	
传真	022-24890198	022-24893466	
电话	022-24893466	022-24890198	
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com	ir@tianjin-pcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司所处行业情况

1) PCB 的产业跟随着电子终端（Electronics）和半导体（Semiconductor）同步发展

PCB 是随着电子连接系统发展而来的，开始解决的是电子终端中各个器件的连接；随着电子终端技术的发展，PCB 更多承载是各个芯片（半导体）的连接；通常 PCB 的产值在终端价值的 3%-4%左右；但半导体越来越重要，在终端中的价值占比越来越高。

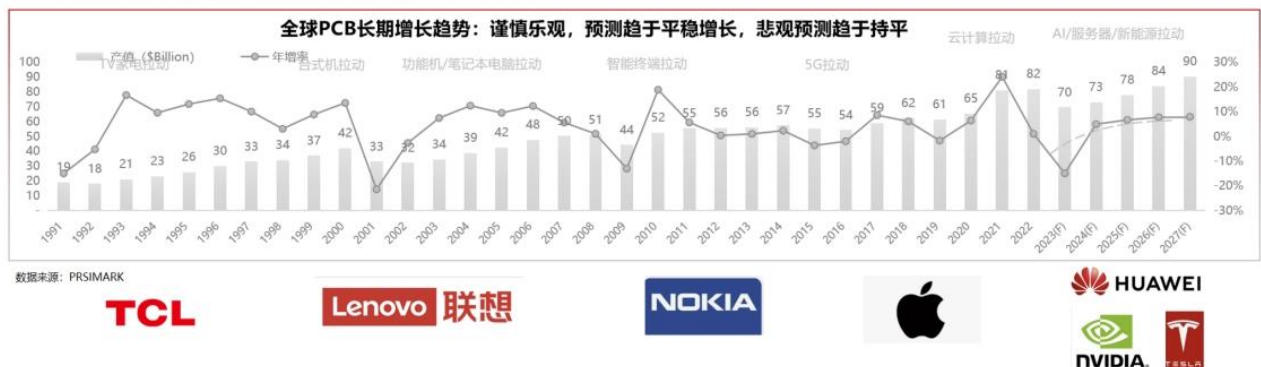
图表：PCB 的产值跟电子终端（Electronics）和半导体（Semiconductor）之关系

单位：BN	2000	2010	2017	2022	2027	2000-2010	2010-2022	2022-2027
Electronics	1131	1558	2019	2426	2920	3.30%	3.80%	3.80%
Semiconductor	204	291	412	573	716	3.6%	5.8%	4.6%
PCB	43	53	59	82	98	2.40%	3.80%	3.80%
PCB /Electronics	3.80%	3.40%	2.92%	3.38%	3.36%			
PCB /Semiconductor	21.1%	18.2%	14.3%	14.3%	13.7%			

资料来源：PRISMARK

每次产业发生巨大变革，都有一个领先的企业引领行业发展，带领着行业技术发展；从家电到 PC、从 PC 到手机、从功能机到智能机；现在新技术变革时代又要到来；根据行业咨询机构统计，未来五年终端的增量需求里面，排名前三位的是服务器（500 亿美金+）、汽车（470 亿美金+）、手机（500 亿美金+）。

图表：全球 PCB 的需求及变化



2) 技术上“后摩尔时代”系统级封装发展：对基板提出新的需求；

排名前三位的是服务器、汽车、手机，他们对 PCB 的需求决定着 PCB 未来技术发展方向，这三个业务的需求背后是数据传输的大幅增长；一方面数据的传输需要更高的带宽，更高的带宽就需要高频高速的材料，这个是材料的变化；另一方面是芯片处理的数据量越来越大，处理的实时响应要求越来越高，这就需要芯片和芯片之间的数据传输更快，板级互联成为趋势。

更深远的影响是数据高增长带来的产业链的变化，先进封装的需求爆发式增长，增加 I/O 数量和增加传输速率是目前行业确定的改进方向，在这两个方向上都带了 PCB 新的需求，特别是在基材的变化，从 BT 材料走向 ABF 材料，未来再到玻璃材料；在先进材料方面，天津普林也将在新赛道上尝试探索，提高自己的技术能力。

图表：未来印制电路发展两大趋势



由于摩尔定律的“失效”，晶体管密度无法实现像过去一样每两年翻一番，否则成本和复杂性将不断攀升。因此，行业研究重点将从芯片级发展转向创新封装和载板技术，也就是如何将多个芯片集成到单个封装载体。行业正通过分解构建单个芯片功能，从系统级芯片 SOC 转向芯片级系统 SIP；目前 GPU 已经成为异构集成实现高性能架构的极佳案例，将 GPU 处理芯片和多个堆叠的 HBM 内存模块集成在同一封装内；异构集成方法包括嵌入式桥接、面板级封装、玻璃载板，从长远来看，演进到 CP0 共封装光学器件，随着铜互联逐渐接近极限，硅光电学提供了具有更高速度、更大范围、更低延迟的解决。

天津普林在 2024 年 12 月在深圳举办 TCL 全球技术创新大会中，首次对外展出了华星光电和天津普林联合研发的玻璃芯基板，也是本次展会主题“AI·显见未来”方向上一个重要产品，受到参展人员的热烈追捧。随着 AI 技术的迭代，对更高性能的超低损耗材料的需求正在增加，下一代半导体封装的玻璃芯基板在 AI 产业链上受到各大玩家的重视。天津普林对外展示的玻璃芯基板是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。

(2) 报告期内公司从事的主要业务

1) 公司发展历程：

公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板、等，专注于中小批量、高多层、厚铜板、光电板和 HDI 领域的 PCB 领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。

图表：天津普林的发展历程



2) 公司的主要经营模式：

(1) 采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

(2) 生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。

(3) 销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快速的配送方式。

公司多年来一直专心致力于 PCB 产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验，凭借丰富的产品结构、齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合 PCB 百强企业和内资 PCB 百强企业。

3) 公司的业务发展

随着公司 2023 年完成对泰和电路的收购，公司 2024 年新拓展了深圳项目，公司实现了多工厂多基地的布局；天津基地以工控、汽车、航空及科研专用为主；华南基地珠海以显示光电、惠州以线圈厚铜等为主、深圳未来以高端特种快板业务为主。

报告期内公司实现营业收入 112,821.67 万元，较上年同期增长 74.57%。在面临行业竞争加剧，单价下行的环境中，公司实现收入大幅度增长；收入的增长一方面来自于公司业务量的增长；另一方面公司完成了对泰和电路的并表。

报告期内公司毛利率为 16.79%，较上年同期下降 5.42%。其中，天津基地 2024 年度毛利率为 17.82%，较上年同期下降 5.12%，华南基地 2024 年度毛利率为 15.58%，较上年同期下降 5.71%。公司毛利率下降主要因为客户降价所致。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,386.44 万元，较上年同期增长 28.16%。主要原因是泰和电路并表。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,423.06 万元，较上年同期下降 66.39%。主要原因是 2023 年第四季度票据支付货款比例增加，2024 年度票据到期解付，现金支出增加。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,954,764,453.20	1,502,564,487.67	30.10%	760,157,689.13



归属于上市公司股东的净资产	480,991,749.18	451,482,538.11	6.54%	442,189,028.29
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,128,216,723.91	646,266,845.89	74.57%	580,724,657.09
归属于上市公司股东的净利润	33,864,374.18	26,424,489.91	28.16%	16,058,910.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,518,675.42	30,310,951.38	0.69%	34,536,848.31
经营活动产生的现金流量净额	34,230,561.91	101,850,766.34	-66.39%	22,503,905.53
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%	0.07
加权平均净资产收益率	7.23%	5.88%	1.35%	3.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,605,113.95	269,532,477.99	313,295,258.55	298,783,873.42
归属于上市公司股东的净利润	9,968,227.57	10,717,882.68	10,252,094.17	2,926,169.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,862,836.45	8,000,273.10	10,141,007.58	2,514,558.29
经营活动产生的现金流量净额	-23,012,193.43	42,251,042.35	-7,204,239.21	22,195,952.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,374	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
TCL 科技集团（天津）有限公司	境内非国有法人	26.86%	66,026,154	0			
天津市中环投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	6,499,600	0			
石卫东	境内自然人	2.35%	5,779,704	0			
吴平	境内自然人	2.26%	5,560,500	0			
丁遂	境内自然人	1.77%	4,343,812	0			
刘仕刚	境内自然人	1.44%	3,531,100	0			
深圳创富汇投资管理有限公司 —创富汇全球视野 2 号私募证	其他	1.11%	2,740,250	0			



券投资基金						
深圳创富汇投资管理有限公司 —创富汇全球视野 3 号私募证 券投资基金	其他	1.02%	2,512,700	0		
陈潮海	境内自然人	0.99%	2,442,400	0	不适用	0
陆彦通	境内自然人	0.93%	2,287,290	0	不适用	0
上述股东关联关系或 一致行动的说明	天津市中环投资有限公司为 TCL 科技集团（天津）有限公司的全资子公司。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	不涉及					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

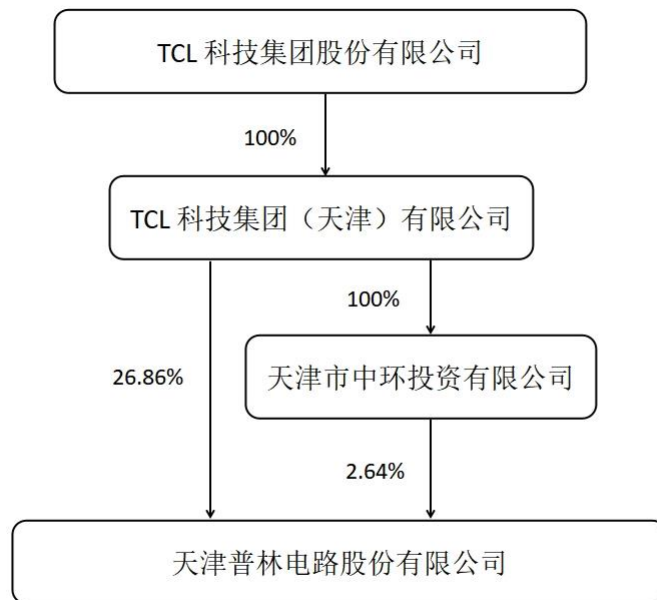
☐适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三十五次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，并于 2024 年 5 月 9 日披露了《天津普林电路股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》。公司计划拟以简易程序向特定对象发行股份，募集资金总额不超过 9,000.00 万元（含本数），用于公司 PCB 智能制造技改项目。授权有效期将于 2024 年年度股东大会召开之日止。